

熱対策の上流から下流までを体感する

総合技術セミナー

聞いて、 触れて、 理解する

AIの進化や半導体の高性能化により、
熱対策の難易度は年々高まっています。
こうした課題に対し、いま求められているのは
材料単体ではなく、
解析・材料・実装・測定までをつなぐ

“全体最適の視点”です。

本セミナーでは、最新の技術動向とともに、
熱対策の上流から下流までを一貫してご紹介します。

※ 2026年8月より太陽金網株式会社は「株式会社TWC」へ社名変更いたします。

2026 9.4 金

13:00 ~ 17:00
(懇親会 17:00 ~ 19:00)



大手町ファーストスクエアカンファレンス Room A・B・D
(東京都千代田区大手町 1-5-1 大手町ファーストスクエアイーストタワー 2F)



定員
100名(先着順)

主催 株式会社TWC (旧: 太陽金網株式会社)



TWC

ファブレスメーカーとしての可能性を広げて、想いをカタチに

解析

材料

実装

測定

参加費
無料

01



株式会社サーマルデザインラボ
代表取締役

国峯 尚樹 様

最新機器における TIM の活用と選定方法

電子機器の小型・高性能化に伴い、放熱手段は多様化しています。従来のヒートシンクやファンによる冷却が難しい機器も増え、基板や筐体を放熱に活用するケースが広がっています。また、AI サーバやパワーデバイスの高出力化により、高性能 TIM への要求も一層高まっています。こうした中、多様な材料の中から自製品に適したものを選定するには、熱特性だけでなく、実装性や信頼性を含めた総合的な判断が重要です。

本講演では、最近の電子機器における TIM の適用事例を踏まえ、有効な選定・活用方法について解説します。

02



株式会社ベテル
ハドソン研究所

羽鳥 仁人 様

熱伝導率測定の規格と測定法について

精度の高い熱設計やシミュレーションには、材料の熱伝導率や接触熱抵抗を正確に把握することが重要です。また、熱伝導率の測定手法は多岐にわたり、材料の種類や形状に応じた適切な選定が求められます。

本講演では、代表的な測定規格の考え方を紹介するとともに、バルク材、薄板・シート、微小領域など、各種測定手法について事例を交えながら解説します。

03



株式会社 TWC

松本 大介

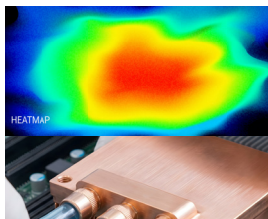
世界最高性能 積層型ベーパーチャンバー「FGHP」の紹介

GPU などの高性能 SoC や GaN・SiC パワーデバイスの高出力化・高密度実装が進み、発熱密度は急激に増大しています。その結果、従来の熱設計手法では対応が難しい課題が顕在化しています。こうした背景のもと、新たな熱輸送の考え方として注目されるのが、積層型ベーパーチャンバー「FGHP」です。FGHP は、高い高温強度と独自の内部構造により、局所的に集中した熱を効率的に拡散し、従来材料では難しかった熱拡散特性を実現します。

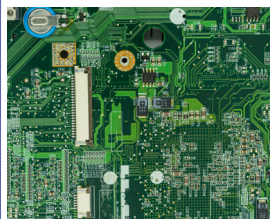
本講演では、FGHP の構造や動作原理、ならびにその熱特性について、適用事例を交えながら技術的観点から紹介します。

デモ・展示 ※写真はイメージです。

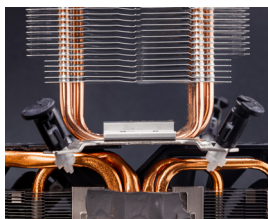
ベーパーチャンバー /
FGHP の紹介
(ヒートスポット改善)



熱解析技術
(シミュレーション事例)



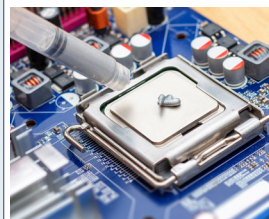
熱対策複合技術
(FGHP 実装例)



測定技術
(TIM 材の熱・物性評価)



実装技術
(TIM 材の塗布・実装方法)



注意事項

本セミナーの内容・講師・スケジュール等は、都合により予告なく変更となる場合がございます。
あらかじめご了承ください。

お問い合わせ



<https://www.twc-net.co.jp/ask/ask.html>